

LSPACK をご使用の前に

1. 本製品はシステムでの開発または評価での使用を想定したものです。また国内の使用に際して電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。
2. LSPACK は CSSOCKET/BSSOCKET と共に振動および衝撃環境にはご使用になりません。
3. LSPACK をケースから取り出す時は本体を押さえてからスポンジを先に取り出して、ピンの曲がりや折れにご注意下さい。
4. ケースを 50 以上の場所に長時間放置すると変形する場合がありますので、40 以下の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
5. LSPACK は構造上フラックス及び洗浄液がソケット内部に残る為、フラックスの浸漬やフラックス洗浄は絶対に行わないで下さい。又、他の DIP 部品との併用においても DIP 部品側のフラックス等が LSPACK のガイドピン穴よりソケット内に入る恐れがありますのでフラックス洗浄は行わないで下さい。
6. LSPACK をネジ止めする時は添付の専用ドライバーまたはトルクドライバーでネジを仮止めした後に順次ネジを締めして下さい。ネジの締め付けトルクを目安値は $0.054\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.55\text{kgf}\cdot\text{cm}$) です。1ヶ所のみを強く締めると接触不良の原因となることがあります。
7. IC のハンダボールの表面が汚れ又は、酸化していると接触不良の原因となりますのでハンダボール表面の汚れや酸化膜を落としてから LSPACK に搭載して下さい。
8. システムの評価後に長時間放置する場合は、LSPACK のカバー側及び基板側のネジの締め付けを緩めることをお勧めします。